



基本資料

行業	半導體
已發行股數	51.86 億
股價	134.16 美元
市值	6,957.64 億美元
每股資產淨值	12.76 美元
市盈率	37.57 (X)
核數師	德勤會計師事務所

財務資料概要

(百萬元, 台幣)

綜合損益表	2018/12	2019/12	2020/12	2019 Q4	2020 Q4
收入	1,031,362	1,069,989	1,339,255	317,237	361,533
按年增長%	-----	3.75%	25.17%	-----	13.96%
淨利	351,131	345,264	517,885	116,035	142,766
按年增長%	-----	(1.67%)	50.00%	-----	23.04%
每股盈利 (台幣)	13.54	13.32	19.97	4.47	5.51

資產負債表	2018/12	2019/12	2020/12	2019 Q4	2020 Q4
現金	577,815	455,399	660,171	455,399	660,171
應收賬款	128,613	138,909	146,038	138,909	146,038
流動資產	951,680	822,614	1,092,185	822,614	1,092,185
非流動資產	1,138,352	1,442,111	1,668,526	1,442,111	1,668,526
總資產	2,090,032	2,264,725	2,760,711	2,264,725	2,760,711
流動負債	340,543	590,736	617,151	590,736	617,151
非流動負債	72,089	51,974	292,938	51,974	292,938
總負債	412,632	642,710	910,089	642,710	910,089
權益	1,677,400	1,622,015	1,850,622	1,622,015	1,850,622

現金流量表	2018/12	2019/12	2020/12	2019 Q4	2020 Q4
經營現金流	588,803	630,456	834,148	206,109	260,975
投資現金流	(332,350)	(477,716)	(519,044)	(175,299)	(92,959)
融資現金流	(241,892)	(266,041)	(86,834)	(16,644)	(101,048)

主要財務比率	2018/12	2019/12	2020/12	2019 Q4	2020 Q4
淨利率	34.05%	32.27%	38.67%	36.58%	39.49%
股本回報率	20.93%	21.29%	27.98%	7.15%	7.71%
資產回報率	16.80%	15.25%	18.76%	5.12%	5.17%
流動比率 (X)	2.79	1.39	1.77	1.39	1.77
現金比率 (X)	1.70	0.77	1.07	0.77	1.07

來源: Bloomberg

公司業務簡介

台灣積體電路製造股份有限公司是全球最大的晶片代工企業，根據IC Insights，該公司於2019年市場份額超過50%。

收入來源

1 智慧型手機晶片

截至2020年底，此分部收入佔整體48%，約6428.42億台幣，同比升23%。

2 高效能運算晶片

截至2020年底，此分部收入佔整體33%，約4419.54億台幣，同比升39%。

3 物聯網晶片

截至2020年底，此分部收入佔整體8%，約1071.40億台幣，同比升28%。

4 車用電子晶片

截至2020年底，此分部收入佔整體3%，約401.77億台幣，同比降7%。

5 消費性電子晶片

截至2020年底，此分部收入佔整體4%，約535.70億台幣，同比升2%。

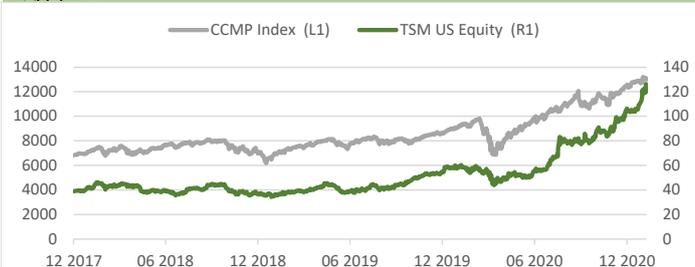
十大機構投資者持股

機構名稱	持有股數	百分比
Capital Group Cos Inc	79,704,200	1.54%
JPMorgan Chase & Co	63,527,184	1.22%
Sun Life Financial Inc	42,495,289	0.82%
Sanders Capital LLC	41,400,710	0.80%
Bank of New York Mellon Corp	39,569,898	0.76%
WCM Investment Management	32,349,374	0.62%
Fisher Asset Management	27,509,549	0.53%
Vanguard Group Inc	26,694,521	0.51%
Wellington Management Group	25,162,557	0.49%
FMR LLC	17,584,768	0.34%
合計	395,998,050	7.64%

總發行股份數量	5,186,076,092	100.00%
---------	---------------	---------

來源: Bloomberg

股價表現



券商目標價

機構名稱	建議	目標價	潛在回報
HSBC	買入	148	10.50%
Morningstar, Inc	持有	136	1.37%
Goldman Sachs	買入	171	27.46%
Bernstein	跑贏大市	149	11.06%
Susquehanna Financial	負面	74	-44.84%
GF Securities Co. Ltd.	買入	119	-11.60%

來源: Bloomberg, 只包括2021年1月份起發表報告券商

	機構數目	平均目標價	潛在回報
正面	5	146.71	9.36%
中性	1	136.00	1.37%
負面	1	74.00	-44.84%

投資要點

技術領先同業

台積電屬行業龍頭，而且是首批進入7納米製程的廠商，目前其技術已踏入5納米製程，以上兩個高端製程產品的收入在2020年第四季已佔整體收入49%左右，並已宣佈3納米製程的計劃。

市場對高端晶片需求上升

隨著人工智能、物聯網等高科技進一步發展，市場對高端製程晶片需求將會提升，預期需求將會傾斜於擁有行業高端技術的台積電。

巨大準入壁壘

晶片生產屬於高資本產業，新進入市場者除面對資本要求外，技術要求、人才稀缺、提升良率等等亦是行業正在面對的問題，以上種種令行業構成一個重大的準入壁壘。

公司持續拿下重大訂單

隨著公司踏入5納米製程，來自蘋果、AMD、Qualcomm等紛紛向台積電提出代工要求，即使華為因政治因素而取消訂單，其他客戶已立即爭奪台積電的產能，可見市場對公司產品需求殷切。

風險因素

市場競爭者優秀

雖然目前高端晶片代工行業屬寡頭壟斷局面，但行業中的競爭者亦相當出眾，其中韓國三星電子更是長期競爭者，其技術程度亦與台積電相近，兩者均重視在研發的投入，若台積電未來在技術上被超越，將是潛在風險。

產品技術瓶頸

雖然公司在技術方面相對擁有優勢，但有消息指，台積電及三星電子之前宣布3nm晶片的計劃之中，台積電採用的技術進度出現延遲，而三星亦面對困難，消息指正式量產時間或延後一季。

地緣政治風險

目前中國廠商與台灣廠商之間存在重大的技術分野，如未來中國實行其武力統一計劃，或台灣國民黨上場當政，則預期兩者差距將會收窄。

潛在訂單流失

由於公司主力開拓高端晶片產品，導致公司在生產線的配置上偏重高端晶片，而中低端晶片的客戶或轉向採購由其他廠商代工的晶片。

近期新聞

15/1/2021 台積電今年資本支出料大增至介乎250至280億美元

台積電法說會上提到去年資本支出為172.4億美元。今年預估將介乎250至280億美元之間，預計80%會使用在先進製程，包含3納米、5納米及7納米技術；大約10%會用於先進封裝及光罩製作；約10%會用於特殊製程。公司表示，投入年度資本支出是基於對未來數年成長的預期所規劃，主要考量四大原則，包括技術領先、彈性並反應需求的製造能力、保有客戶信任、獲取適當的報酬。

12/1/2021 Intel擬夥台積電生產第二代PC用圖像芯片 與Nvidia競爭

英特爾計劃夥台積電生產第二代個人電腦用離散圖像芯片，以與輝達競爭。消息稱，該芯片名為「DG2」，採用台積電尚未正式命名新製造工序，但屬7微米工藝的改善版本。消息稱，該芯片料今年較後時間或2022年面世，與Nvidia及AMD遊戲芯片競爭，料成本介乎400至600美元。消息補充，「DG2」較南韓三星電子去年秋季推出用於Nvidia最新一輪圖像芯片的8微米工序更為先進。

31/12/2020 傳3nm製程難度增 台積電、三星量產或延一季

台積電及三星電子之前宣布3nm晶片的計劃，惟市場消息指台積電採用的技術進度出現延遲，而三星亦面對困難，消息指正式量產時間或延後一季，台積電11月下旬舉行南科晶圓18廠3nm廠新建工程上樑典禮，並已通知設備供應鏈將在明年第三季中正式開廠，設備會按計劃入廠裝機。

28/12/2020 傳PS5獲7nm晶片產能 明年總出貨量有望達1,800萬台

Sony 旗下PS5供不應求，不過明年情況有望緩解，據台灣傳媒引述業內消息指明年PS5總出貨量產能有望達1,680-1,800萬台。報道引述半導體供應消息指，PS5的處理器設計者AMD 確定取得台積電的7nm晶片追加產能等，估計明年PS5主晶片封測量有望達140-150萬顆。

評價

買入

我們認為，隨著人工智能、自動駕駛等等新興科技發展需要更高的運算效率，高端半導體的需求將會持續強勢，台積電作為高端半導體巨頭將會持續受惠，我們亦預期當公司的3納米製程產品落實投產後，將令公司的發展進一步拋離其他中端代工企業，亦有利其估值提升。

免責聲明

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。